

Technisches Datenblatt

EtroX[®] V - ASTM

Typische Industrien

- Elektronik
- Halbleiterindustrie
- Reinraumtechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Semiconductor CMP
- Semiconductor Hohe und tiefe Temperatur
- Semiconductor Back-End-Anwendungen

| | Testverfahren | Einheit | Wert |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------|
| Allgemeine Eigenschaften | | | |
| Moisture | ASTM D6980 | % | 0.11 |
| Mechanische Eigenschaften | | | |
| Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 14320 |
| Tensile Modulus | ASTM D638 | ksi | 765 |
| Reißdehnung | ASTM D638 | % | 3.5 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 23214 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | ksi | 791 |
| Thermische Eigenschaften | | | |
| Heat Deflection Temperature | ASTM D648 @ 264psi and 2C/min | °C | >205 |

